

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

**截至2022年6月30日止6個月
中期業績公告**

財務摘要

- 銷售額升約45.1%至108.5百萬美元
- 毛利為42.2百萬美元，躍升45.0%
- 毛利率為38.9%
- 本公司擁有人應佔期內溢利淨額為21.8百萬美元
- 每股盈利為0.87美仙(等同於6.74港仙)
- 訂單出貨比率為1.0

中期業績

晶門半導體有限公司（統稱「本公司」）的董事宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2022年6月30日止6個月的未經審核簡明綜合中期業績連同上年度同期的比較數字列載如下：

中期簡明綜合損益表

截至2022年6月30日止6個月

		未經審核	
		6月30日止6個月	
	附註	2022 千美元	2021 千美元
銷售額	4	108,548	74,828
銷售成本		(66,344)	(45,720)
毛利		42,204	29,108
研究及開發成本		(14,874)	(12,118)
銷售及分銷開支		(1,984)	(1,377)
行政開支		(3,954)	(5,353)
其他收入及收益－淨額		290	272
投資收入－淨額	6	21,682	10,532
		13	101
應佔聯營公司盈利		21,695	10,633
		76	108
除稅前溢利	5	21,771	10,741
所得稅開支	7	(13)	(70)
期內溢利		21,758	10,671
應佔：			
－本公司擁有人		21,760	10,710
－非控股權益		(2)	(39)
		21,758	10,671
本公司普通權益持有人應佔的每股溢利：(美仙)	8		
－基本		0.87	0.43
－攤薄		0.87	0.43

中期簡明綜合全面收入報表

截至2022年6月30日止6個月

	未經審核	
	6月30日止6個月	
	2022	2021
	千美元	千美元
期內溢利	21,758	10,671
其他全面收益／(虧損)		
於往後期間，其他全面收益／(虧損)將重新分類至損益表：		
－換算海外業務時產生之匯兌差額	113	(27)
期內全面收益總計	21,871	10,644
應佔：		
－本公司擁有人	21,873	10,683
－非控股權益	(2)	(39)
	21,871	10,644

中期簡明綜合財務狀況表

於2022年6月30日

		未經審核 於6月30日 2022 千美元	經審核 於12月31日 2021 千美元
	附註		
非流動資產			
無形資產		236	505
物業、廠房及設備		5,610	4,269
使用權資產		2,500	2,315
於聯營公司的投資		1,158	1,082
按公平價值計入其他全面收益的股權投資		1,065	1,065
其他應收款，預付款及訂金	10	7,107	9,087
非流動資產總計		17,676	18,323
流動資產			
存貨		47,017	40,866
應收款及其他應收款、預付款項及訂金	10	44,451	38,967
已抵押的銀行存款		12,000	17,000
現金及現金等價物		47,420	24,757
流動資產總計		150,888	121,590
流動負債			
應付款及應付票據及其他應付款	11	59,512	50,149
銀行計息貸款		181	—
租賃負債		1,330	1,139
遞延收入		3	3
應付稅款		355	342
流動負債總計		61,381	51,633
流動資產淨值		89,507	69,957
總資產減流動負債		107,183	88,280
非流動負債			
銀行計息貸款		—	181
租賃負債		1,301	1,392
非流動負債總計		1,301	1,573
資產淨值		105,882	86,707
權益			
本公司擁有人應佔權益			
已發行股本		32,149	32,123
儲備		73,791	54,640
		105,940	86,763
非控股權益		(58)	(56)
總權益		105,882	86,707

中期簡明綜合財務資料附註

1. 一般資料

晶門半導體有限公司及其附屬公司為無晶圓廠半導體集團，專門設計、開發及銷售專有集成電路晶片產品及系統解決方案，能廣泛應用於智能手機、平板電腦、電視／顯示器、筆記本電腦以及其他智能產品，包括電子貨架標籤、可穿戴產品、醫療保健設備、智能家居設備，以及工業用設備等作各類顯示及觸控應用。

本公司於2003年11月21日根據開曼群島公司法（1961年法律3，經綜合及修訂）第22章在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處的地址為2/F., Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103，開曼群島，而其香港總辦事處的地址為香港新界沙田香港科學園科技大道東3號無線電中心6樓607-613室。

本公司自2004年4月8日起，在香港聯合交易所有限公司主板上市。除另有列明外，本中期簡明綜合財務資料均以美元作呈列單位。

本中期簡明綜合財務資料乃經審閱但未經審核，並於2022年8月19日獲批准刊發。

2. 編製基準

本集團截至2022年6月30日止6個月（「回顧期內」）的未經審核中期簡明綜合財務資料已根據香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。未經審核中期簡明綜合財務資料並沒有載有一般收錄於年度綜合財務報表之所有資料及附註，故此，應與本公司截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表一併閱讀。

3. 重大會計政策

除就本期間之財務資料所採納下列首次生效的經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）外，編製未經審核中期簡明綜合財務資料所採納之會計政策與編製本集團截至2021年12月31日止年度之綜合財務報表所採納者一致。

會計政策及披露之變動

本集團已於本期間之財務資料首次採納下列經修訂之香港財務報告準則：

香港財務報告準則第3號之修訂	<i>對概念框架的提述</i>
香港會計準則第16號之修訂	<i>物業、廠房及設備：未作擬定用途前的所得款項</i>
香港會計準則第37號之修訂	<i>虧損性合約－履行合約的成本</i>
<i>2018年至2020年的年度改進</i>	香港財務報告準則第1號、第9號、第16號的說明例子及香港會計準則第4號之修訂

採納上述經修訂之準則對本財務資料並沒有重大財務影響。

- (a) 香港財務報告準則第3號之修訂在無需大幅修改其規定下，以2018年6月發佈之財務報告概念框架內之提述，取代過往有關編製及呈列財務報表的框架內之提述。該等修訂亦為香港財務報告準則第3號之確認原則增加一項例外情況：實體可參考概念框架釐定資產或負債之構成要素。該例外情況規定，對於單獨產生而非於業務合併中繼承，且屬於香港會計準則第37號或香港財務報告詮釋委員會—詮釋21範圍內之負債及或然負債，正應用香港財務報告準則第3號之實體應分別參照香港會計準則第37號或香港財務報告詮釋委員會—詮釋21，而非參照概念框架。此外，該等修訂澄清有關或然資產於收購日期不符合確認入賬資格。由於期內並無進行業務合併，該等修訂並無對本集團財務狀況及表現產生任何影響。
- (b) 香港會計準則第16號之修訂禁止實體從物業、廠房及設備成本中，扣除在資產達到管理層預定之可使用狀態(包括位置與條件)過程中產生之全部出售所得。相反，實體須將出售任何有關項目之所得款項以及該等項目之成本計入損益。本集團已對2021年1月1日可供使用之物業、廠房及設備項目追溯應用該等修訂。由於並無出售任何於2021年1月1日可供使用之物業、廠房及設備所生產之項目，該等修訂並無對本集團財務狀況或表現產生任何影響。
- (c) 香港會計準則第37號之修訂澄清，就根據香港會計準則第37號評估合約是否屬虧損性而言，履行合約之成本包括與合約直接相關之成本。與合約直接相關之成本包括履行該合約之增量成本(例如直接勞工及材料)及與履行合約直接相關之其他成本分配(例如分配履行合約所用物業、廠房及設備項目之折舊開支以及合約管理與監督成本)。一般及行政費用與合約並無直接關係且將排除在外，除非合約明確向對手方收費，則屬別論。本集團已對2022年1月1日尚未履行其全部責任之合約預先應用該等修訂，且並無發現任何虧損性合約。因此，該等修訂並無對本集團財務狀況或表現產生任何影響。
- (d) 2018年至2020年的年度改進載列香港財務報告準則第1號、第9號、第16號的說明例子及香港會計準則第41號之修訂。預計適用於本集團之修訂之詳情如下：
- 香港財務報告準則第9號金融工具：澄清於實體評估新訂或經修改之金融負債條款是否與金融負債原本之條款存在實質差異時所計及之費用。該等費用僅包含借款人與貸款人之間已支付或已收取之費用，當中包括借款人或貸款人代表對方支付或收取之費用。本集團已對2022年1月1日或之後修改或交換之金融負債預先應用該等修訂。由於本集團金融負債於期內並無進行修改，該等修訂並無對本集團財務狀況或表現產生任何影響。

- 香港財務報告準則第16號租賃：刪除香港財務報告準則第16號隨附之說明例子第13條中有關租賃物業裝修之出租人付款說明。此舉消除於應用香港財務報告準則第16號有關處理租賃優惠上之潛在混亂。

4. 分部資料及銷售額分類

本集團主要從事設計、開發、銷售專有IC產品及系統解決方案，能廣泛應用於智能手機、平板電腦、電視／顯示器、筆記本電腦以及其他智能產品，包括電子貨架標籤、可穿戴產品、醫療保健設備、智能家居設備，以及工業用設備等作各類顯示及觸控應用。

本集團一直在單一營運分部經營，即設計、開發及銷售專有IC產品及系統解決方案。

本集團最高營運決策層為本集團行政總裁暨領導下的執行董事和高級管理層。執行董事和高級管理層檢討本集團內部報告以評估業績及分配資源。管理層基於該等報告確定營運分部報告。

截至2022年6月30日止6個月，銷售額為108,548,000美元（2021年上半年：74,828,000美元）。

本公司的所在地位於香港。本集團主要於香港經營其業務。於回顧期內，本集團之產品主要銷售予位於香港及台灣的客戶。

(a) 按地域市場分類的客戶合約收益

	未經審核	
	6月30日止6個月	
	2022	2021
	千美元	千美元
香港	62,675	40,220
中國內地	6,133	8,528
台灣	18,734	14,112
日本	9,092	4,217
歐洲	7,618	7,100
韓國	328	463
東南亞	290	35
美國	3,341	54
其他	337	99
	108,548	74,828

銷售額按客戶所在地區／國家分類。

(b) 按產品種類分類的客戶合約收益

	未經審核 6月30日止6個月	
	2022 千美元	2021 千美元
新型顯示ICs	49,731	31,696
OLED顯示ICs	15,072	17,377
移動顯示及移動觸碰ICs	37,189	16,883
大型顯示ICs	6,556	8,872
	108,548	74,828

(c) 非流動資產

	未經審核 6月30日 2022 千美元	經審核 12月31日 2021 千美元
香港	3,617	5,413
中國內地	5,070	3,349
台灣	1,701	1,788
韓國	3	7
	10,391	10,557

非流動資產(不包含金融工具)乃根據資產的所在地予以列載。

(d) 資本開支

	未經審核 6月30日止6個月	
	2022 千美元	2021 千美元
物業、廠房及設備		
中國內地	1,625	527
香港	361	387
台灣	55	55
	2,041	969

資本開支是根據資產的所在地予以列載。

(e) 主要客戶

截至2022年6月30日止6個月,最大客戶位於香港,其銷售額為43,146,000美元,佔本集團總銷售額超過10%。截至2021年6月30日止6個月,最大客戶位於香港,其銷售額為28,232,000美元,佔本集團總銷售額超過10%。

5. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利乃扣除／(計入)下列各項後得出：

	未經審核 6月30日止6個月	
	2022 千美元	2021 千美元
銷貨成本	58,747	47,498
過時或滯銷存貨的撥備／(回撥)，淨額	7,277	(2,072)
無形資產攤銷	269	258
物業廠房設備折舊(附註)	622	527
使用權資產折舊	692	668
2019冠狀病毒病相關租賃減免	78	—
外匯差額，淨額	(712)	97

附註：折舊開支320,000美元(2021年上半年：294,000美元)已於銷售成本中支銷，而31,000美元(2021年上半年：45,000美元)則於研究及開發成本中入賬及271,000美元(2021年上半年：188,000美元)於行政開支中入賬。

6. 投資收入－淨額

	未經審核 6月30日止6個月	
	2022 千美元	2021 千美元
利息收入	82	126
銀行貸款的利息支出	(22)	—
租賃負債的利息支出	(47)	(25)
	13	101

7. 所得稅

本集團因有承前自以往年度之可動用稅務虧損可用以抵銷本集團本期內及過往期間產生之應課稅溢利，因此並無作香港利得稅撥備。海外所得稅則根據本集團的營運所在國家／司法權區之適用稅率計算。

	未經審核 6月30日止6個月	
	2022 千美元	2021 千美元
即期－其他地區		
－本期支出	13	70
遞延所得稅	—	—
本期所得稅開支總額	13	70

8. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利是根據本公司的擁有人應佔本集團之溢利及本期內已發行普通股加權平均數2,493,446,274股(2021上半年:2,485,479,976股)計算。

本公司的擁有人期內應佔本集團之溢利為21,760,000美元(2021上半年:10,710,000美元)。

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利乃根據本公司的擁有人應佔本集團之溢利及已就期內所有具潛在攤薄影響的普通股作出調整後之已發行加權平均普通股數計算。

加權平均普通股股數的有關資料列載如下：

	股份數目 未經審核	
	6月30日止6個月	
	2022	2021
已發行加權平均普通股股數	2,493,446,274	2,485,479,976
兌換所有可予發行具攤薄影響的流通購股權(i)	1,283,976	4,586,626
用作計算每股攤薄盈利的調整後加權平均普通股股數	2,494,730,250	2,490,066,602

- (i) 已對所呈列的截至2022年6月30日止6個月的每股基本盈利額作出有關攤薄31,200,000份尚未行使的購股權(2021年6月30日止6個月:12,900,000份)的調整，該等購股權的加權平均普通股股數乃假設所有具攤薄影響的潛在普通股於被視為兌換為普通股時已無償發行。

9. 股息

於2022年3月23日舉行的會議上，董事建議截至2021年12月31日止年度派發末期股息每股普通股為1.0港仙。末期股息已於2022年7月27日派發。

董事會亦決議不宣派截至2022年6月30日止6個月的中期股息(截至2021年6月30日止6個月:無)。

10. 應收款及其他應收款、預付款項及訂金

	未經審核 6月30日 2022 千美元	經審核 12月31日 2021 千美元
應收款	19,806	22,082
關聯方應收款	7,803	2,250
減值撥備	(220)	(220)
應收款—淨額	27,389	24,112
其他應收款、預付款項及訂金	17,027	14,690
關聯方預付款	103	233
減值撥備	(68)	(68)
應收款及其他應收款、預付款項及訂金		
— 流動	44,451	38,967
其他應收款、預付款及訂金		
— 非流動	7,107	9,087
	51,558	48,054

於2022年6月30日，本集團對企業客戶之應收款信貸期主要為30至90日。應收款以發票日期及扣除減值撥備的賬齡分析如下：

	未經審核 6月30日 2022 千美元	經審核 12月31日 2021 千美元
1–30日	16,525	9,795
31–60日	5,410	6,515
61–90日	3,219	5,452
91–180日	2,235	2,350
	27,389	24,112

應收款減值撥備變動如下：

	未經審核 6月30日 2022 千美元	經審核 12月31日 2021 千美元
於期初／年初	220	220
減值撥備／(回撥)	—	—
於期末／年末	220	220

11. 應付款及應付票據及其他應付款

	未經審核 6月30日 2022 千美元	經審核 12月31日 2021 千美元
應付款及應付票據	25,916	23,919
應計開支及其他應付款	21,738	18,891
合約負債	5,761	6,350
關聯方合約負債	4,489	—
退款負債	1,608	989
	59,512	50,149

於2022年6月30日，應付款及應付票據以發票日期的賬齡分析如下：

	未經審核 6月30日 2022 千美元	經審核 12月31日 2021 千美元
1–30日	13,040	14,726
31–60日	10,120	6,478
61–90日	2,297	2,439
超過90日	459	276
	25,916	23,919

管理層討論及分析

業務回顧及展望

業務回顧

過去一年，雖然受新冠肺炎持續爆發、物流延誤、瓶頸和運輸成本上升等因素影響，全球供應鏈和晶片短缺的壓力仍然存在，但本集團能夠成功對抗這些挑戰。儘管大中華地區內各市的封鎖措施和各種旅遊限制仍然普遍，但全球經濟活動復蘇和客戶習慣改變，推動大眾對電動汽車和5G智能手機的需求，加上可穿戴設備和AIoT/IoT裝置需求持續穩定，均使本集團受惠。由於2022年上半年全球半導體需求依然強勁，原材料和採購成本均有所增加，導致行業整體銷售價格上升。

持續的利淡因素對半導體行業的每一個參與者都帶來新的挑戰，但同時也帶來新的機遇。為解決晶片元件短缺問題，於2021年初，本集團與領先的海外晶圓代工廠達成協議，依託彼此建立的關係維持穩定的晶片元件供應，以支持本集團產品於2022年的需求。

亮麗表現

於截至2022年6月30日止期間（「期內」），市場對本集團產品的需求仍然強勁。本集團因進行策略性採購，成功調整產品組合，重點發展高端產品。高效的供應鏈管理確保了集團平穩的營運和長期發展，同時本集團堅持創新、努力執行發展戰略，對市場趨勢高瞻遠矚，締造了出色的表現和業績。集團銷售收入增長強勁，期內總銷售額約108.5百萬美元，較去年同期增長超過45.1%（2021年上半年：74.8百萬美元）。

新型顯示IC

新型顯示IC產品主要指雙穩態顯示產品。雙穩態顯示是一種非傳統的顯示技術，顯示設備通過反射環境光來照明。

期內，本集團新型顯示IC產品的銷售額顯著增長，這是由於產品組合有所改善以及將產品重點轉移到高端產品上。需求增長來自歐洲及北美市場的電子貨架標籤。電子貨架標籤愈來愈普及，其能夠實現自動標價和價格更換，這不僅減少浪費，還可加快標價速度，讓銷售人員能夠專注於其他工作。對零售商依然，電子貨架標籤不僅可減少商戶的碳足跡，使他們更加環保，還可提高效率和降低長期成本。

電子貨架標籤不僅在歐洲及北美普及，在亞洲國家亦成為新興趨勢。本集團與元太科技工業股份有限公司（「元太科技」）攜手合作，為用於電子貨架標籤和零售標牌的新一代電子墨水專用平台Spectra™ 3100，共同研發出嶄新的顯示IC解決方案。於2021年，我們取得重大技術突破，研發出能夠四色顯示的電子貨架標籤。這項重大突破使集團得以在該日益蓬勃的市場中佔據領先地位。預計四色顯示將於2023年推出，屆時將進入量產以用於先進彩色電子紙墨水屏(ACeP)的顯示IC產品。為進一步開拓電子標牌和電子閱讀器市場，集團開發了特定的驅動IC，預期即將開始量產。作為擁有最大市場份額的電子紙顯示驅動IC供應商，本集團致力提供高品質和可靠的產品，滿足客戶的嚴格要求。

OLED顯示IC

本集團提供多種OLED顯示驅動IC，應用廣泛，包括無源矩陣OLED（「PMOLED」）、mini/micro-LED產品和OLED照明產品等。集團是全球領先的PMOLED顯示驅動IC廠商，按2021年及期內付運量計算，屬全球領先的供應商。

本集團提供從圖標、單色和灰階顯示到全彩色高度集成的全系列PMOLED驅動IC，是便攜式設備的理想顯示解決方案。期內，集團的OLED顯示業務受惠於PMOLED可穿戴設備、智能家居解決方案和物聯網(IoT)/人工智能物聯網(AIoT)解決方案強勁的市場需求。用戶對這些設備要求有更多功能，加上產品升級，為需求帶來動力。

我們的下一代顯示技術里程碑將會是使用大量在低溫多晶硅(LTPS)背板上排列的微小micro-LED芯片而製成的Micro-LED顯示。晶門半導體是mini/micro-LED應用的先行者，其中，用於50至100英寸室內顯示標牌的mini-LED DDI解決方案自2018年至今一直在量產，於英國和美國地鐵站的曲面顯示標牌中使用。隨着全球高級電子消費品市場不斷擴大，預期本集團mini/micro-LED IC產品的訂單將有所增長。

隨着社交距離限制放寬，全球大多數發達國家正在過渡到後疫情時代，這導致本集團的便攜式醫健產品IC的需求放緩。然而，由於智能家居產品需求依然蓬勃，加上消費者都希望能購買在技術、性能、功能和設計方面都有所加強的升級產品，故全球物聯網市場是一個備受歡迎的新機遇。為抓緊這需求機遇，本集團已戰略性地將產品重點轉移到提供更高價值和更複雜功能的產品上。

移動顯示及移動觸控IC

晶門半導體提供並不斷開拓多種移動顯示及移動觸控IC解決方案，包括內嵌式觸控顯示驅動IC、TFT顯示驅動IC、STN顯示驅動IC、MIPI橋接IC和顯示控制IC，支援廣泛的工業和消費產品，如智能手機、平板電腦、可穿戴設備、遊戲裝置和物聯網設備等。

期內，儘管市場對消費電子產品的需求減少，連帶使移動顯示器的需求下跌，但移動觸控IC產品不論銷量還是平均售價都有顯著增長。這完全抵銷了移動顯示器需求下跌所帶來的負面影響，使銷售收入較2021年上半年有大幅度增加。

於2021年，作為集團最新研發的專有方案，本集團推出了其首個全彩色內嵌式觸控顯示(TDDI)驅動IC，專門用於可穿戴裝置和物聯網應用，功能卓越，兼具高成本效益和低功耗的優點。我們預計市場對TDDI的需求將於2022年和2023年穩步增長。

本集團是MIPI顯示解決方案的先驅，提供一系列專有功能，支持智能設備的高分辨率、高速和低功耗顯示。我們的MIPI局部調光IP已準備好商品化，預定於2022年第四季推出市場。此外，本集團正在與一家領先的中小型TFT-LCD顯示器面板廠商，聯合開發人機介面顯示平台，以充分利用集團領先的TDDI技術優勢。此IC解決方案預計將於2022年第三季進入量產。

對於能讓操控更準確、反應更快捷及電池運行時間更長的遊戲控制器IC，其市場需求正快速增長。本集團前瞻這市場趨勢，積極發揮在TDDI深厚的專業能力，以探索板塊內的創新應用場景。我們已成功取得至2022年和2023年的生產訂單，這將為集團可持續的收入基礎，帶來顯著貢獻。

大型顯示IC

本集團提供多種大型顯示驅動IC解決方案，支持顯示器、筆記本及大尺寸電視等應用。

期內銷售收入較2021年上半年為低，這是由於新冠疫情和客戶偏好改變。本集團推出了應用於165Hz高刷新率電競機種遊戲顯示屏和8K高清電視的高速點對點(P2P)顯示驅動IC，其採用了嶄新的架構，數據傳輸速度高達3.6Gbps。高端娛樂市場正蓬勃發展，這最新的高速介面產品將能提升集團之產品價值及在市場內的知名度。

產品開發

本集團重視創新產品開發，緊貼新興的技術進步和瞬息萬變的市場趨勢。集團因此不斷物色新的合作機會，以發揮技術優勢和豐富的知識產權，以期推動我們加速進入多個目標市場，帶領我們在較少探索的領域獲得理想回報。

於回顧期內，集團研發出適用於高分辨率無源選址驅動micro-LED的調制系統框架，較於傳統的PMOLED面板中所使用的集成電路有更高的分辨率。該嶄新的解決方案也能有效縮短TFT基板的開發時間，具有明顯的成本效益優勢。

獎項及表彰

晶門半導體矢志領導下一代的技術創新，成就卓越的公司管治。2022年7月，本集團榮獲「香港回歸25周年企業貢獻大獎」，以表揚集團對香港可持續經濟和社會發展的貢獻。我們對獲獎相當榮幸，並認為這是對集團的一種鼓勵，使集團能夠繼續大力創新，啟發年青一代努力工作，擁抱「獅子山精神」。

展望

全球經濟日益錯綜複雜，科技發展愈加發達，半導體技術正扮演重要角色，幾乎在所有電子產品中無處不在。半導體驅動各項科技和應用，人們得以在家辦公，遙距學習，網購各種商品，與親友以至世界保持聯繫。

全球各地正陸續放寬旅遊及社交距離限制，但新冠疫情依然繼續影響各行各業，尤其Omicron變種病毒的威脅仍未消除。供應鏈問題普遍持續，而雖然全球供應鏈問題和芯片短缺未如2021年嚴重，但芯片價格仍維持在較高水平。儘管物流和原材料成本價格壓力不斷加大，但本集團仍將繼續為客戶開發和提供增值產品。

為保持集團業務增長和提高全球知名度，本集團正努力開發支持七種顏色的嶄新電子紙顯示器IC解決方案，並努力為電子閱讀器市場提供新穎的顯示IC解決方案。

隨着集團的mini-LED顯示IC產品上市，我們將向一線客戶加強推廣，以擴大集團的市場份額。

本集團積極把握遊戲機控制器市場的發展趨勢，計劃為玩家提供前所未有的遊戲體驗。為捕捉元宇宙的市場潛力，我們打算發揮集團在高速和高分辨率顯示IC技術方面的能力，開發增強AR和VR產品。

隨着尺寸更大的高分辨率電視陸續面市，本集團正實施推廣計劃，以建立穩固的市場地位。

在過去兩年，本集團成功應對各種變化和挑戰，同時更保持亮麗業績。作為公司發展策略的一部分，我們將繼續專注於為我們的客戶創造價值，同時從不斷變化的趨勢中尋找機會。

財務回顧

收入及業績回顧

本集團期內收入增長約45.1%至108.5百萬美元(2021年上半年：74.8百萬美元)。收入增加是由於本集團將其產品重點轉移到提供更高價值和更複雜功能的產品上。這產品組合的戰略性變化帶來了平均售價和整體銷售收入的增加。本集團期內整體訂單出貨比率為1.0(2021年上半年：2.0)。

期內的毛利和毛利率分別為42.2百萬美元和38.9%(2021年上半年：分別為29.1百萬美元和38.9%)。毛利大幅增長主要是由於截至2022年6月30日止6個月的產品組合改變。

銷售及分銷開支為2.0百萬美元，行政開支為4.0百萬美元，較去年同期分別為增加44.1%和下降26.1%。期內銷售及分銷開支增長與業務增長一致，而行政開支下降主要是由於期內美元相對大多數其他貨幣升值，而本集團行政開支主要產生自中國、香港和台灣，因此兌換成美元後金額降低。

作為一家領先的科技公司，本集團致力投資於產品工程研發和業務發展，然而，集團在產品工程研發支出方面仍然保持審慎，其於期內的工程研發費用為14.9百萬美元(主要是員工成本和無形資產攤銷)(2021年上半年：12.1百萬美元)，約佔截至2021年6月30日止6個月總銷售額的13.7%(2021年上半年：16.2%)。

本集團於期內錄得母公司擁有人應佔淨溢利為21.8百萬美元(2021年上半年：10.7百萬美元)。董事會不建議宣派截至2022年6月30日止6個月的中期股息。

流動資金及財務資源

	未經審核 6月30日 2022 千美元	經審核 12月31日 2021 千美元
流動資產	150,888	121,590
流動負債	61,381	51,633
流動資產淨值	89,507	69,957
流動比率	2.46	2.35
債務權益比率	0.002	0.002

於2022年6月30日，本集團的流動比率為2.46(2021年12月31日：2.35)，反映集團財務狀況具有強健的流動資金水平。流動資產淨值所代表的營運資金狀況為89.5百萬美元(2021年12月31日：70.0百萬美元)，與去年財務年結相比並無顯著不利變化。

本集團投資於財務資產(主要為銀行存款)作資金管理以獲取利息及股息收入。於回顧期內，本集團錄得利息收入82,000美元(2021年上半年：126,000美元)。

整體結果，本集團於財務投資錄得淨投資收入13,000美元(2021年上半年：101,000美元)。

庫務管理

本集團設有內部庫務審閱小組（「小組」），負責執行庫務管理政策、審閱整體投資組合及定期監察投資表現以提升現金儲備的回報率。該小組定期與外聘之投資組合管理經理進行會面或電話會議及舉行內部審閱會議以檢討及監察投資表現。

於2022年6月30日，本集團的現金及現金等價物及已抵押銀行存款總計為59.4百萬美元（2021年12月31日：41.8百萬美元），增加17.6百萬美元。當中12.0百萬美元以美元計值（2021年12月31日：17.0百萬美元）屬抵押存款予銀行作融資營運用途。現金及現金等價物和銀行存款主要以美元、港元及人民幣結算。

本集團將繼續分配資源於產品開發、保障產能、擴大顧客群及把握市場及銷售商機、進行若干策略性企業投資及用作一般公司營運用途。本集團亦將繼續執行庫務管理政策，於低利率期間增加現金儲備之回報率，於2022年6月30日，除了韓國附屬公司從銀行取得循環信貸金額為181,000美元（以韓圓結算），作營運資金融資，以及由一間香港銀行發出的應付票據2.2百萬美元外，本集團並無任何主要借貸。本集團之現金餘額主要投資於銀行各類存款。

本集團的主要應收及應付款均以美元結算。本集團會密切監察外幣兌換率的變動，以確保能夠以有利的兌換率將美元兌換成其他貨幣，支付當地的營運開支。於回顧期內，由於董事會認為本集團的外匯風險不高，因此本集團並無運用任何衍生工具以對沖其營運方面的外匯風險。

資本開支與或然負債

2022年上半年期間，本集團的資本開支為2,041,000美元（2021年上半年：969,000美元）。

於2022年6月30日，共有1.2百萬美元已商定合約但未撥備之資本開支（2021年12月31日：1.2百萬美元）。

除前述之外，本集團概無其他重大資本承擔或或然負債。

收購及出售重大附屬公司及聯營公司

於回顧期內，本集團並無收購或出售任何重大附屬公司及聯營公司。

資產抵押

於2022年6月30日，金額為12,000,000美元（2021年12月31日：17,000,000美元）的已抵押銀行存款已抵押予銀行作抵押銀行融資用途。

人力資源及薪酬制度

於2022年6月30日，本集團共有311名員工*。整體員工中約35%駐香港總辦事處，其餘員工分別駐中國內地及台灣。僱員薪金及其他福利由2021年上半年約12.7百萬美元增加至本期間約14.0百萬美元，增加10.2%。該增加主要是由於平均工資、花紅及平均僱員人數上升。本集團的薪酬政策乃按個別僱員表現制定，將每年予以檢討。除公積金計劃（根據適用於香港僱員的強制性公積金條例的條款）及政府管理退休金計劃（適用於中國內地及台灣僱員）、醫療及其他保險外，亦會根據個別僱員表現的評估而向僱員授出酌情花紅。

* 數據不包括於中國內地之測試中心

企業管治及補充資料

遵守企業管治守則

董事會及本集團的管理層承諾達到及保持高水平的企業管治，這也是維護業務營運的誠信和保持投資者對本公司信心的關鍵因素。

截至2022年6月30日止6個月期間，本公司一直遵守上市規則附錄14所載之企業管治守則中所有適用的守則條文。

遵守標準守則

本公司備有就董事及有關員工進行的證券交易的書面指引，條款與上市規則附錄10所載的規定標準同樣嚴格。本公司已向全體董事作出具體查詢，於截至2022年6月30日止6個月期間，彼等均一直遵守該等指引。

購買、出售或贖回本公司上市股份

於截至2022年6月30日止6個月期間，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司上市股份。

審閱簡明綜合中期財務資料

審核委員會由3名獨立非執行董事及1名非執行董事組成。未經審核的簡明綜合中期財務資料，已通過管理層聯同審核委員會審閱。

該等未經審核的簡明綜合中期財務資料，已經由本公司獨立核數師安永會計師事務所根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。核數師的獨立審閱報告載於本公司中期報告內。

中期業績於聯交所網站及本公司網站公佈

本公司已於2022年8月19日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.solomon-systech.com)公佈所有根據上市規則規定的本集團的中期財務及相關資料。

代表董事會
晶門半導體有限公司
行政總裁
王華志

香港，2022年8月19日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。

釋義及詞彙

董事會	董事會
中國	中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港及澳門特別行政區
守則條文	上市規則附錄14所載之企業管治守則中的守則條文
本公司	晶門半導體有限公司，一家成立於開曼群島的有限公司，其股份於聯交所主板上市
董事	本公司之董事
電子貨架標籤	電子貨架標籤
本集團	本公司及其附屬公司
香港會計準則	香港會計準則
港元	香港元
香港財務報告準則	香港財務報告準則，或香港會計準則及香港財務報告準則的統稱
香港	香港特別行政區
IC	集成電路晶片
LCD	液晶顯示器
上市規則	聯交所證券上市規則
LTPS	低溫多晶矽，一種製造薄膜電晶體液晶顯示器的技術
元宇宙	元宇宙是一種虛擬現實，它結合了社交媒體、在線遊戲、擴增實境(AR)、虛擬現實(VR)和加密貨幣各個方面，允許用戶進行虛擬交流
MIPI	移動行業處理器界面
標準守則	上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則
OLED	有機發光二極體
PMOLED	無源矩陣有機發光二極體
中國	中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港及澳門特別行政區
工程研發	產品設計、開發及工程
銷售及分銷	銷售及分銷
聯交所	香港聯合交易所有限公司
TDDI	觸控與顯示驅動器集成
TFT	薄膜電晶體
英國	大英聯合王國
美國	美利堅合眾國
美元	美國元
Virtual Reality (VR)	虛擬現實是利用電腦技術創建模擬環境